

证券代码：301282

证券简称：金禄电子

金禄电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-003

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 华福证券有限责任公司 赵心怡 |
| 时 间 | 2023 年 6 月 15 日 15:00-16:00 |
| 地 点 | 金禄电子科技股份有限公司会议室 |
| 形 式 | 现场交流 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 陈 龙；证券事务代表 黄 芬 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、公司产品在各应用领域的销售占比及毛利率情况？</p> <p>答：公司主打汽车尤其是新能源汽车 PCB 市场，2022 年度汽车板收入占主营业务收入的比重超过 52%，其中应用在新能源汽车“三电系统”及充电桩等领域的 PCB 产品收入占汽车板收入的比重约为 4-5 成。此外，公司产品在通信电子领域的收入占比约为 20%，在工业控制及消费电子领域的收入占比各为 10%左右。</p> <p>公司采用成本加成的定价策略，不同应用领域产品的毛利率总体来看不存在较大差异，但应用在汽车电子及工业控制领域的产品毛利率总体上会高于应用在通信电子及消费电子领域的产品毛利率。</p> <p>2、公司目前的产能利用率水平？</p> <p>答：公司 2022 年度的产能利用率为 84.43%。2023 年以来，因受到市场需求不足的影响，PCB 企业普遍面临开工不足、产能利用率不高的状况。</p> |

3、公司不同生产基地的 PCB 产品应用领域方面是否有区分？

答：公司目前有清远和湖北两大生产基地，其生产的 PCB 在应用领域方面不存在明显差异。但总体来说，由于湖北生产基地的自动化水平更高，通信和消费电子领域的大批量订单会优先选择在湖北生产基地进行生产，清远生产基地则主要生产汽车电子和工业控制领域的产品。

4、公司与贸易商客户的合作情况？

答：公司采取“向下游制造商直接销售、通过贸易商销售”相结合的销售模式，主要贸易商客户包括 Fineline Global、DVS、Talent Force、HY GLOBAL 等。其采购公司产品的终端应用领域以汽车、工控等为主。

5、公司与华为有业务合作关系吗？公司产品在光模块领域的应用情况？

答：公司暂未与华为进行直接合作，公司 PCB 有应用于华为的交换机、网关等产品，但该等领域目前不是公司产品主要的应用领域；公司产品有应用于光模块领域，但该等领域目前不是公司产品主要的应用领域。

6、不同应用领域产品对 PCB 层数会有不同要求吗？

答：PCB 为定制化产品，不同产品对 PCB 层数的要求需要具体产品具体分析。总体来说，汽车整体空间较大，使用的 PCB 目前以 2-8 层板为主，相较于服务器等应用领域对产品层数的要求不高，但因为汽车更为复杂的应用环境，对 PCB 的使用寿命、可靠性和稳定性的要求会更高。

7、公司的 HDI 板产能主要是做几阶产品？

答：公司募投项目规划了年产能 48 万平米的 HDI 板，将主要应用于汽车电子领域，并以一阶、二阶为主。

8、公司在汽车智能化领域的业务拓展规划？

答：公司看好 ADAS、智能座舱、T-BOX 等汽车智能化、网联化相关产品的市场前景，将其作为产品研发和业务拓展的重心之

| | |
|-----------------------------|--|
| | <p>一，并将借助公司积累的汽车 PCB 工艺技术、品质管控、客户资源等优势重点开发相关业务市场，培育发展新动能。</p> <p>9、公司单/双面板的下游应用场景有哪些？</p> <p>答：公司单/双面板主要应用于家电、部分传统汽车零部件等领域。</p> <p>10、公司的应收账款回款情况？</p> <p>答：公司根据行业惯例主要采取赊销模式，给予客户的信用期主要为 60-120 天，2022 年度的应收账款周转天数为 109.09 天，总体上与公司给予客户的信用期相匹配。公司应收账款总体回款情况较好，不存在大额坏账、呆账的情形。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p> | <p>本次活动不涉及应披露重大信息。</p> |
| <p>附件清单（如有）</p> | <p>无</p> |
| <p>日期</p> | <p>2023 年 6 月 15 日</p> |